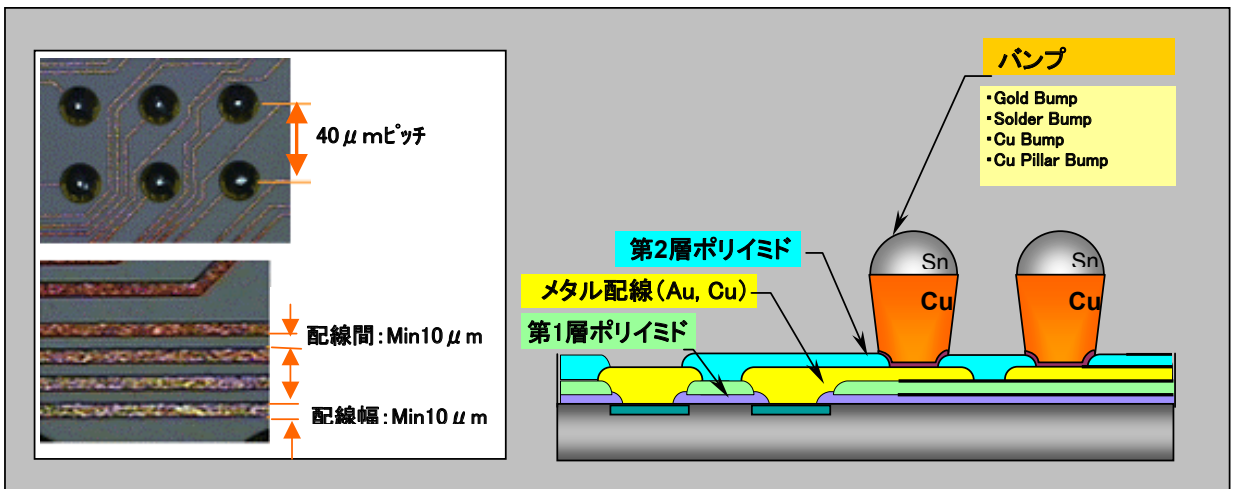


ワイヤーボンディング端子部の再配線加工 & 電極部へのバンプ加工によりICの再設計をすることなく、フリップチップ工法に対応可能です。

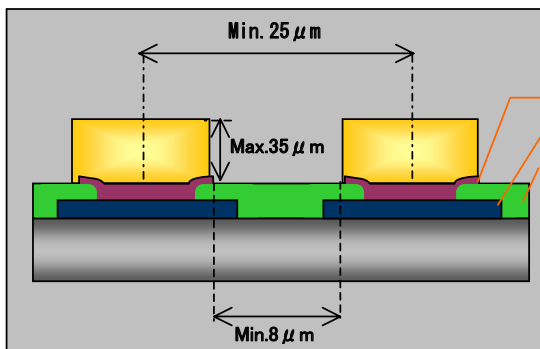
## 特長

- マスク製作最短3日対応 (GDSデータ御支給後)
- 少量試作対応可能 (Min.5枚~)
- 25  $\mu\text{m}$  バンプピッチ対応 (Auバンプ)
- 標準仕様以外のカスタム仕様対応可能

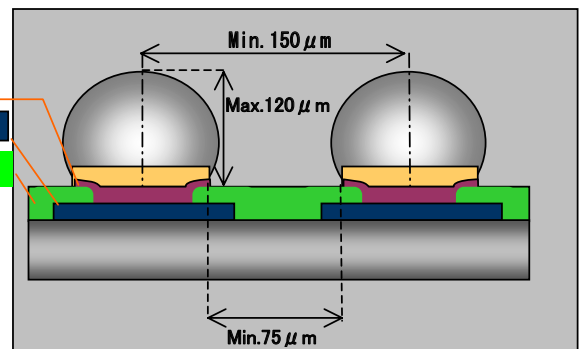
## 再配線加工 (6, 8inch wafer)



## Gold Bump (6, 8inch wafer)



## Solder Bump (6, 8, 12inch wafer)



## サービスフロー

再配線・バンプ仕様打合せ

マスク設計・製作

再配線・バンプ加工

検査

納品